

# 托伦斯 (301583.SZ)

## 新股覆盖研究

### 投资要点

- ◆ 6月24日有一家创业板上市公司“托伦斯”询价。
- ◆ 托伦斯 (301583)：公司专注于为半导体设备、高功率激光器提供精密金属零部件产品，包括工艺零部件、结构零部件、气体管路及系统组装产品等。公司2023-2025年分别实现营业收入2.91亿元/6.10亿元/7.20亿元，YOY依次为2.60%/109.94%/18.00%；归母净利润0.15亿元/1.06亿元/0.98亿元，YOY依次为-54.91%/589.45%/-6.96%。根据公司初步预测，2026H1营业收入较2025年同期增长2.53%至6.53%，归母净利润较2025年同期减少29.46%至36.16%。
- ① **投资亮点：1、公司是国内半导体设备金属零部件的核心供应商，北方华创、中微公司两大设备龙头稳定贡献八成以上收入。**公司深耕半导体关键零部件的研发与生产，业务聚焦于刻蚀、薄膜沉积等工艺壁垒较高的前道核心设备，覆盖逻辑芯片、存储芯片工艺设备以及先进封装等领域。产品端，公司腔体、内衬、匀气盘等关键零部件已实现稳定供货，并持续攻坚多层结构、大截面、复杂水路及气路焊接等行业高技术壁垒，使得国产化率仍待突破的冷盘、多管式加热反射罩、静电卡盘基体等复杂结构关键零部件亦顺利落地，构建出较为完整的产品体系。依托技术先发优势，公司早在2005-2007年便切入国内本土前两大半导体设备厂商北方华创、中微公司的供应链；报告期间，北方华创与中微公司为公司前两大客户、2025年合计贡献八成以上收入，公司在北方华创和中微公司同类型产品的供应链占比则达20%-35%；此外，招股书显示，中微公司直接持有公司近1%的股权，北方华创亦通过旗下投资平台诺华资本的在管基金间接持有公司约3%的股权。据公司在问询函回复中的测算，公司在国内半导体设备金属零部件部分细分行业中稳居前三位水平。**2、公司紧跟行业发展、持续聚焦先进制程领域，2025年先进制程零部件相关收入占比处于较高水平。**我国半导体制造向先进制程的加速演进，为半导体设备及其核心金属零部件创造了显著增长机遇。一方面，制程微缩直接提升了半导体设备的复杂度与数量，单台设备所需的高性能金属零部件数量及价值量同步跃升；另一方面，先进制程下极端工艺环境和加工精度，对金属零部件的材料纯度、耐腐蚀性、热稳定性及微观尺寸精度提出更高要求，利好以公司为代表的具备核心技术实力、且通过主流半导体设备商严苛认证的国内零部件供应商。公司持续聚焦先进制程领域，产品均可适配7nm及以下先进制程需求；据问询函回复披露，报告期内，应用于半导体设备领域的先进制程零部件相关收入占比从2023年的8.13%提升至2025年的23.06%，其中半导体关键工艺零部件的先进制程相关收入占比更是从2023年的6.39%提升至2025年的31.78%。**3、公司产品应用横向拓展至激光设备、医疗设备等领域，积极打造第二增长曲线。**（1）在激光设备领域，公司凭借精密制造工艺以及半导体设备与激光设备行业在部分基础工艺和技术要求上具有的相通性，成功在激光设备零部件产品的高密封性、耐腐蚀性及焊接质量等关键性能指标形成显著优势，现已纳入Lumentum等全球激光设备制造领军企业的供应体系，为其稳定供应高功率激光器的腔体及光纤激光器的冷却部件；2025年，激光设备零部件相关收入突破4600万元。（2）在医疗设备领域，公司主要生产医疗设备中的精密结构件，由于产品核心功能聚

### 交易数据

总市值 (百万元)	
流通市值 (百万元)	
总股本 (百万股)	139.11
流通股本 (百万股)	
12个月价格区间	/

### 分析师

李蕙  
 SAC执业证书编号：S0910519100001  
 lihui1@huajinsec.cn

### 分析师

戴箐箐  
 SAC执业证书编号：S0910526030001  
 daizhengzheng@huajinsec.cn

### 相关报告

- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告 (吉和昌)-2026年70期-总第707期 2026.6.23
- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告 (华润新能源)-2026年69期-总第706期 2026.6.21
- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告 (科莱瑞迪)-2026年68期-总第705期 2026.6.16
- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告 (臻宝科技)-2026年67期-总第704期 2026.6.11
- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告 (惠科股份)-2026年66期-总第703期 2026.6.9



焦于设备的机械支撑与模块化连接，与公司在材料加工及结构设计方面的技术能力形成一定的适配度；目前，相关医疗结构件产品已成功导入行业主流客户的供应链体系，形成了少量收入。

- ② **同行业上市公司对比：**公司聚焦半导体设备、高功率激光器精密金属零部件领域；根据主营业务的相似性，选取富创精密、先锋精科、珂玛科技、臻宝科技为托伦斯的同行可比公司。从上述可比公司来看，2025年可比上市公司的平均收入规模为 16.81 亿元，平均 PE-TTM（剔除异常值/算术平均）为 167.22X，平均销售毛利率为 38.16%；相较而言，公司营收规模与销售毛利率未及可比公司平均。

- ◆ **风险提示：**已经开启询价流程的公司依旧存在因特殊原因无法上市的可能、公司内容主要基于招股书和其他公开资料内容、同行业上市公司选取存在不够准确的风险、内容数据截选可能存在解读偏差等。具体上市公司风险在正文内容中展示。

### 公司近 3 年收入和利润情况

会计年度	2023A	2024A	2025A
主营收入(百万元)	290.6	610.1	719.8
同比增长(%)	2.60	109.94	18.00
营业利润(百万元)	15.8	120.3	110.1
同比增长(%)	-53.50	661.28	-8.51
归母净利润(百万元)	15.3	105.5	98.2
同比增长(%)	-54.91	589.45	-6.96
每股收益(元)	0.20	0.81	0.71

数据来源：聚源、华金证券研究所

## 内容目录

一、托伦斯.....	4
(一) 基本财务状况.....	4
(二) 行业情况.....	5
(三) 公司亮点.....	8
(四) 募投项目投入.....	9
(五) 同行业上市公司指标对比.....	10
(六) 风险提示.....	10

## 图表目录

图 1: 公司收入规模及增速变化.....	4
图 2: 公司归母净利润及增速变化.....	4
图 3: 公司销售毛利率及净利润率变化.....	5
图 4: 公司 ROE 变化.....	5
图 5: 2011 至 2025 年中国境内、全球半导体设备市场规模.....	6
图 6: 2020 年至 2025 年全球及中国境内半导体设备零部件市场规模.....	7
图 7: 2020 年至 2025 年全球半导体设备机械类零部件、金属零部件市场规模.....	7
图 8: 2020 年至 2024 年中国境内半导体设备机械类零部件、金属零部件市场规模.....	8
表 1: 公司 IPO 募投项目概况.....	9
表 2: 同行业上市公司指标对比.....	10

## 一、托伦斯

公司是专注于精密金属零部件研发、生产和销售的综合服务商，致力于为半导体设备提供高性能的关键工艺零部件、工艺零部件、结构零部件、气体管路及系统组装产品等；同时，公司工艺能力覆盖激光设备领域，可提供高功率激光器所需的激光器腔体和冷却工艺零部件产品。

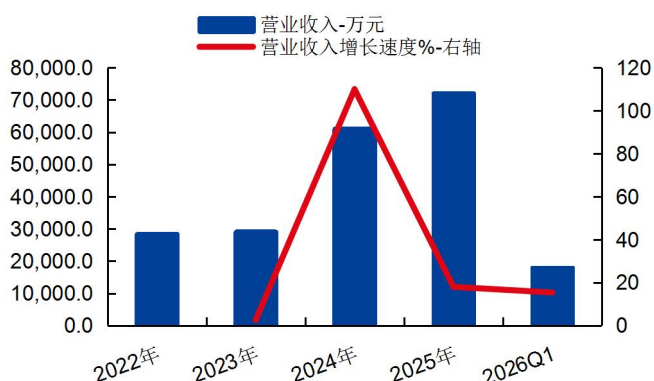
在技术工艺能力上，公司整体工艺水平位居国内厂商第一梯队，核心技术全面覆盖高精度机械制造、焊接及表面处理三大领域，并进一步形成了复杂精密零部件工艺整合与检测能力；目前，该复杂精密零部件工艺整合与检测能力已获得国内头部半导体设备厂商的高度认可，多款产品已进入北方华创、中微公司等客户半导体设备的供应体系并应用于刻蚀设备、薄膜沉积设备、抛光设备、退火设备等核心设备，覆盖逻辑芯片工艺设备、存储芯片工艺设备及先进封装等领域，并成功导入国际知名激光设备企业 Lumentum 的供应链，充分凸显公司技术的国际竞争力。

### （一）基本财务状况

公司 2023-2025 年分别实现营业收入 2.91 亿元/6.10 亿元/7.20 亿元，YOY 依次为 2.60%/109.94%/18.00%；归母净利润 0.15 亿元/1.06 亿元/0.98 亿元，YOY 依次为 -54.91%/589.45%/-6.96%。根据最新财报情况，2026Q1，公司实现营业收入 1.79 亿元，同比增长 15.37%；实现归属于母公司净利润 0.15 亿元，同比减少 14.58%。

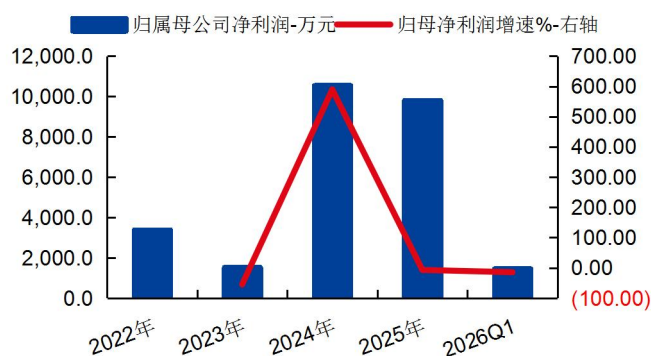
2025 年，公司主营业务收入按产品类别可分为五大板块，分别为半导体关键工艺零部件（3.58 亿元，占 2025 年主营收入的 50.21%）、半导体工艺零部件（0.93 亿元，占 2025 年主营收入的 12.97%）、半导体结构零部件（1.98 亿元，占 2025 年主营收入的 27.74%）、激光设备零部件（0.46 亿元，占 2025 年主营收入的 6.49%）、其他产品（0.19 亿元，占 2025 年主营收入的 2.60%）。2023-2025 年，半导体关键工艺零部件板始终为公司主要收入来源，收入占比稳定在 40%以上；而在半导体关键工艺零部件当中，又以内衬、匀气环、腔体产品为主体。

图 1：公司收入规模及增速变化



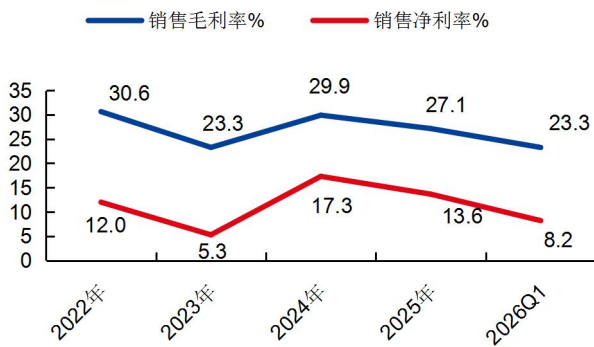
资料来源：iFind，华金证券研究所

图 2：公司归母净利润及增速变化



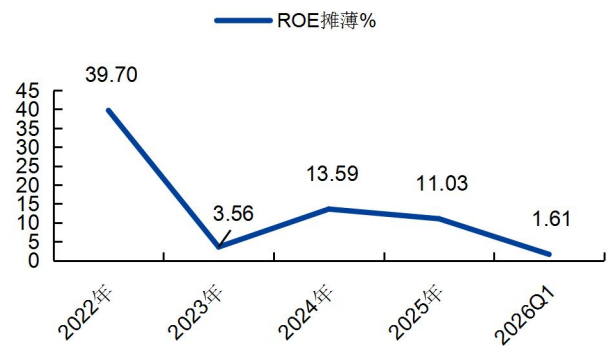
资料来源：iFind，华金证券研究所

图 3：公司销售毛利率及净利润率变化



资料来源：iFind，华金证券研究所

图 4：公司 ROE 变化



资料来源：iFind，华金证券研究所

## （二）行业情况

公司产品以半导体设备关键工艺零部件、工艺零部件、结构零部件、气体管路及系统组装产品等为主；根据产品类别，公司归属于半导体设备金属零部件行业。

### 1、半导体设备行业

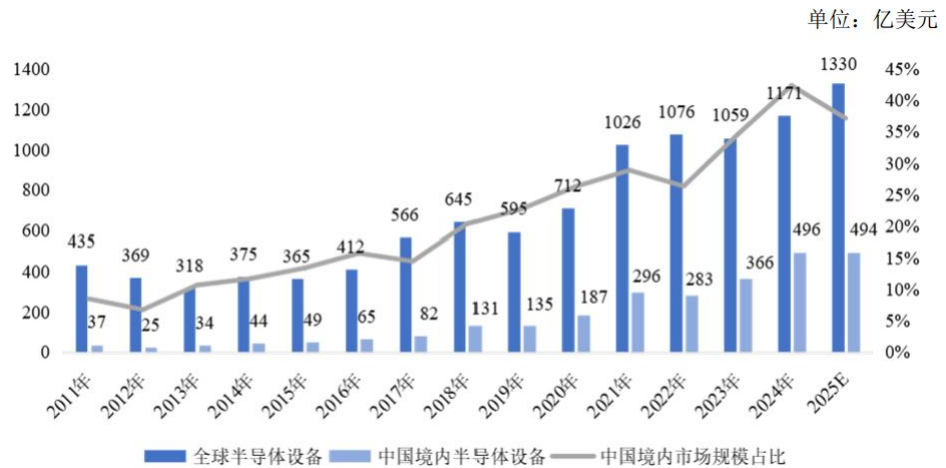
半导体设备是半导体产业链的核心组成部分，具有高占比、高投入、高技术壁垒的特点，在芯片制造中发挥着关键作用。根据 SEMI 数据，2024 年全球半导体设备销售额同比增长 10% 至 1,171.4 亿美元，创下历史新高纪录。从区域来看，中国境内、韩国和中国台湾省是半导体设备支出的前三大市场，合计占全球市场份额的 74%，其中中国境内销售额同比增长 35%，达到 495.5 亿美元，连续第五年成为全球最大半导体设备市场。

根据 SEMI 数据，半导体制造领域的设备投资一般占半导体制造领域资本性支出的 70%-80%，且随着工艺制程的提升，设备投资占比也相应提高。半导体设备在产业链中的应用领域主要可分为前道晶圆制造和后道封装测试两大类。其中，前道晶圆制造占据更大比重，根据 SEMI 数据，全球半导体设备市场中前道设备市场规模占比超 90%，其中，刻蚀技术、薄膜沉积技术与光刻技术并称三大主要生产技术，也是前道设备中价值量最高的三大设备类型，其中，刻蚀设备、薄膜沉积合计价值量占比超 40%。

近年来，全球半导体设备市场呈现出积极的发展态势。根据 SEMI 最新公布数据显示，2024 年全球半导体设备销售额同比增长 10% 至 1,171.4 亿美元，超越 2022 年的 1,076.4 亿美元，创下历史新高纪录。前道设备中，得益于对先进制程和成熟逻辑、先进封装和高带宽存储器（HBM）产能扩张的投资增加，进而对以刻蚀、薄膜沉积为代表的前道设备需求量增加。后道设备领域在连续两年下滑之后，在人工智能和 HBM 制造日益复杂且需求不断增长的推动下，于 2024 年强劲复苏，其中封装设备销售额同比增长 25%，测试设备销售额同比增长 20%。同时，在人工智能驱动应用相关的芯片需求增加的趋势下，全球半导体设备产业市场规模预计在未来三年还将继续增长，根据 SEMI 统计数据，全球半导体设备产业市场规模于 2025 年 1-9 月已实现销售规模超 987 亿美元，有望在 2026 年、2027 年分别攀升至 1,450 亿美元、1,560 亿美元。

而国内方面，国内半导体设备市场已实现从“跟跑”到“领跑”的跨越，根据 SEMI 统计数据，2020 年，中国境内半导体设备市场以 187 亿美元的销售额首次成为全球第一大市场；至 2024 年，其市场规模进一步增长至 496 亿美元，同比增长 35%，占全球市场份额超过 40%；2025 年 1-9 月，中国境内半导体设备市场规模约 362 亿美元，仍是全球最大市场。根据华泰证券研究所预测，尽管 2025 年受海外设备出口管制影响导致前期 Fab 厂商提前备货，使得 2025 年需求有所消退，但中国境内半导体设备市场规模仍将保持全球首位，预计可达 494 亿美元。

图 5：2011 至 2025 年中国境内、全球半导体设备市场规模



资料来源：SEMI，公司招股书，华金证券研究所

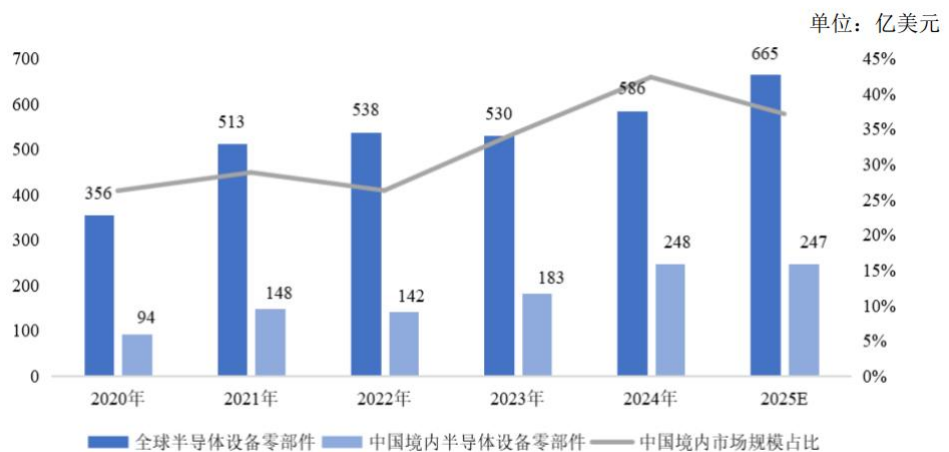
### (1) 半导体设备金属零部件行业

半导体设备零部件行业是半导体产业链的重要支撑环节。半导体设备零部件是指在材料、结构、工艺、品质、精度、可靠性及稳定性等性能方面达到半导体设备及技术要求的零部件。半导体设备由成千上万的零部件组成，其可靠性、稳定性乃至迭代升级，很大程度上依赖于精密零部件的质量、性能与技术突破。因此，半导体零部件是决定整个半导体产业高质量发展的关键领域。半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的产业规律，而半导体设备作为半导体制造环节的设备供应商，对于延续“摩尔定律”至关重要。

从价值量占比来看，设备零部件在设备总支出中占比很高，例如在刻蚀机台、薄膜沉积机台中，其成本结构中的直接原材料占比，即零部件成本占比超过 85%，结合半导体设备的毛利率来看，设备零部件通常占半导体设备价值量的 50%。半导体零部件产业具有高技术密集、学科交叉融合、市场规模小而分散、但在价值链中举足轻重等特点。由于用于精密的半导体制造，半导体零部件具备精度高、批量小、多品种、尺寸特殊、工艺复杂、要求严苛等特征，生产常需兼顾强度、应变、抗腐蚀、电子特性、电磁特性、材料纯度等复合功能要求，技术门槛极高。同时，其研发设计、制造与应用涉及材料、机械、物理、电子、精密仪器等多学科交叉，对复合型人才的需求显著。

半导体设备金属零部件市场规模与半导体设备市场规模相关，根据国内半导体设备上市公司披露，半导体设备直接原材料成本占据半导体设备营业成本的 90%，结合设备公司毛利率情况测算，半导体设备零部件市场规模约为半导体设备市场规模的 50%，结合全球及中国境内半导体设备市场规模测算，半导体设备零部件市场规模情况如下：

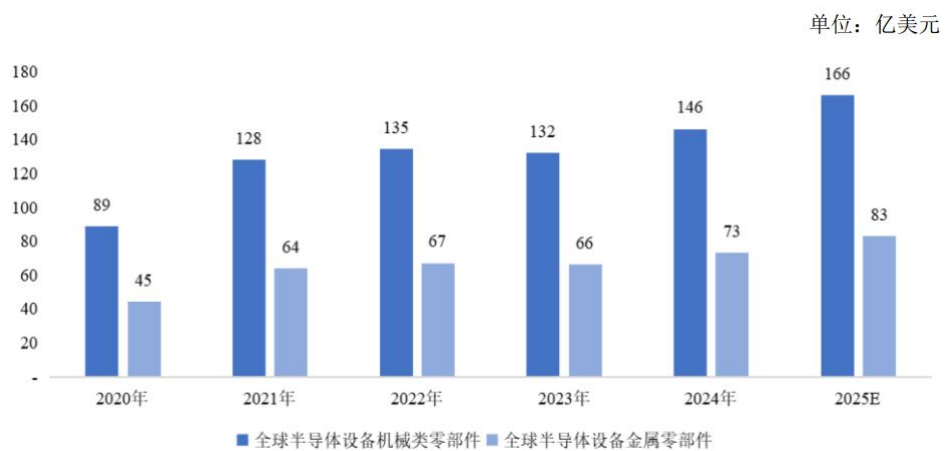
图 6：2020 年至 2025 年全球及中国境内半导体设备零部件市场规模



资料来源：SEMI，华金证券研究所

参考同行业公司市场研究报告，半导体设备机械类零部件价值约占半导体零部件价值量的 25%，而半导体设备机械类零部件可进一步细分主要包括金属件、石英件、陶瓷件等，参考富创精密招股说明书、先锋精科招股说明书以及市场研究报告的计算方式，金属零部件价值量占比约为 50%，据此测算，发行人所处的全球半导体设备机械类零部件、金属零部件市场规模如下：

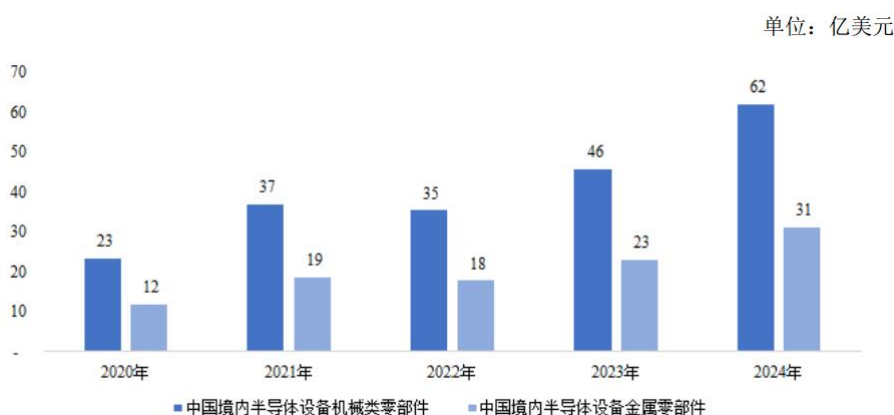
图 7：2020 年至 2025 年全球半导体设备机械类零部件、金属零部件市场规模



资料来源：SEMI，华金证券研究所

国内方面，根据 SEMI 数据，2025 年 1-9 月中国境内实现半导体设备销售规模约 362 亿美元，销售规模仍居全球市场首位。同时，根据 SEMI 报告预测，2026 至 2028 年间国内在 300mm 晶圆厂设备领域的投资将高达 940 亿美元，位居全球首位。这一大规模投资将直接带动半导体设备及其零部件的强劲需求，为国产金属零部件企业开辟广阔的市场空间。对于国内半导体设备零部件企业而言，其未来市场规模增长将与中国半导体设备企业的营收情况相关，参考 2024 年中国境内半导体设备市场规模 496 亿美元测算，若国产化率每提升 10 个百分点，将释放 49.6 亿美元国产设备采购需求，将直接体现为半导体设备厂商的收入增量，进而为本土半导体设备零部件企业带来 24.8 亿美元的收入增量空间，其中本土金属零部件厂商收入增量有望超 3.1 亿美元，将主要体现在头部金属零部件厂商收入增长之中。

图 8：2020 年至 2024 年中国境内半导体设备机械类零部件、金属零部件市场规模



资料来源：SEMI，华金证券研究所

竞争格局方面，国际上大型企业凭借其长期积累的技术优势、品牌优势以及完善的客户服务体系成为了国际性半导体设备厂商的供应商，又基于国际性半导体设备厂商的较大市场份额使得其在全球市场中也占据了较大份额。这些企业在高精密制造技术、特殊表面处理工艺以及材料研发等方面处于行业较高水平，能够为全球顶尖的半导体设备制造商提供高质量、高性能的金属零部件产品，在高端市场形成了较高的竞争壁垒。国际竞争格局方面，全球市场由美、日企业主导，头部企业包括日本 Ferrotec、美国超科林及中国台湾京鼎精密，该等国际巨头凭借技术积累和先发优势，在高端金属零部件市场形成了较高壁垒，通过其长期与国际设备厂商构建的供应链体系，使得其市占率处于较高水平。

国内市场竞争则呈现“梯队分化、加速自主可控”的格局，当前国内半导体设备金属零部件市场主要参与者包括：1) 以富创精密、先锋精科、托伦斯为代表的第一梯队，具备较为全面的工艺能力和规模化量产实力；该等厂商覆盖半导体工艺零部件和结构零部件，且已进入中微公司、北方华创等头部半导体设备商供应链，建立了长期合作，并且聚焦金属零部件产品，在机械加工、表面处理及焊接工艺领域技术优势突出。2) 第二梯队为部分具备半导体设备零部件业务的上市公司，聚焦于个别细分产品领域，在特定金属零部件产品线上实现突破，产品已通过国内主流半导体设备厂、晶圆厂验证。3) 第三梯队则为众多中小型机加工企业，主要从事结构零部件代工，工艺水平较为单一，技术水平相对有限。

### (三) 公司亮点

**1、公司是国内半导体设备金属零部件的核心供应商，北方华创、中微公司两大设备龙头稳定贡献八成以上收入。**公司深耕半导体关键零部件的研发与生产，业务聚焦于刻蚀、薄膜沉积等工艺壁垒较高的集成电路前道核心设备，覆盖逻辑芯片工艺设备、存储芯片工艺设备及先进封装等多领域。产品端来看，公司腔体、内衬、匀气盘、加热器等关键零部件已实现稳定批量供货，发展期间持续攻坚多层结构、大截面、复杂水路及气路焊接等行业高技术壁垒，使得国产化率仍待突破的冷盘、多管式加热反射罩、静电卡盘基体、气体分布盘等复杂结构关键零部件亦顺利落地，构建出较为完整的产品体系，并且可适配 7nm 及以下先进制程需求。依托技术层面的先发优势，公司早在 2005-2007 年便切入国内本土前两大半导体设备厂商北方华创、中微公司的供应链，合作至今已逾二十载；报告期内，北方华创

与中微公司长期位列公司前两大客户，2025年更是合计贡献八成以上收入，公司在北方华创和中微公司同类型产品的供应链占比则达20%-35%；此外，招股书显示，中微公司直接持有公司近1%的股权，北方华创亦通过旗下投资平台诺华资本的在管基金（北京集成电路装备产业投资并购基金、北京集成电路装备产业投资并购二期基金）间接持有公司约3%的股权。据公司在问询函回复中的测算，公司在国内半导体设备金属零部件部分细分行业中稳居前三位水平，其中2025年上半年薄膜沉积、刻蚀设备金属精密零部件市场占有率约8.14%，较2024年市占率5.65%显著提升。

**2、公司紧跟行业发展、持续聚焦先进制程领域，2025年先进制程零部件相关收入占比处于较高水平。**我国半导体制造向先进制程的加速演进，为半导体设备及其核心金属零部件创造了显著增长机遇。一方面，制程微缩直接提升了半导体设备的复杂度与数量，单台设备所需的高性能金属零部件数量及价值量同步跃升；另一方面，先进制程下极端工艺环境和加工精度，对金属零部件的材料纯度、耐腐蚀性、热稳定性及微观尺寸精度提出更高要求，对于以公司为代表的具备核心技术实力、且通过主流半导体设备商严苛认证的国内零部件供应商，有望迎来切入高端市场的关键窗口。公司持续聚焦先进制程领域，产品不仅覆盖半导体工艺零部件和结构零部件多品类，还均可适配7nm及以下先进制程需求；据问询函回复披露，报告期内，应用于半导体设备领域的先进制程零部件相关收入占比从2023年的8.13%提升至2025年的23.06%，其中半导体关键工艺零部件的先进制程相关收入占比更是从2023年的6.39%提升至2025年的31.78%，有力夯实其行业标杆地位。

**3、公司产品应用横向拓展至激光设备、医疗设备等领域，积极打造第二增长曲线。**公司依托在半导体精密制造领域积累的高洁净处理、真空钎焊、复杂结构精密加工等核心技术，具备向激光设备、医疗设备和工业母机等领域延伸的技术基础，为公司提供了较好的技术起点。其中：（1）在激光设备领域，公司凭借精密制造工艺以及半导体设备与激光设备行业在部分基础工艺和技术要求上具有的相通性，成功在激光设备零部件产品的高密封性、耐腐蚀性及焊接质量等关键性能指标上形成显著优势，现已纳入Lumentum等全球激光设备制造领军企业的供应体系，为其稳定供应高功率激光器的腔体及光纤激光器的冷却部件；2025年，激光设备零部件相关收入突破4600万元。（2）在医疗设备领域，公司主要生产医疗设备中的精密结构件，由于产品核心功能聚焦于设备的机械支撑与模块化连接，与公司在材料加工及结构设计方面的技术能力形成一定的适配度；目前，相关医疗结构件产品已成功导入行业主流客户的供应链体系，形成了少量收入。

#### （四）募投资项目投入

公司本轮IPO募投资金拟投入1个项目，以及补充流动资金。

**1、托伦斯精密零部件制造及研发基地项目：**主要建设目的为通过新建生产及研发基地，建设精密机械加工、真空焊接、表面处理等生产线及研发中心，提升半导体设备精密零部件的产能、自动化水平及研发能力，持续布局先进制程半导体设备金属零部件核心工艺，满足市场对高性能半导体金属零部件的需求，推动零部件产品的国产化进程。

表 1：公司 IPO 募投资项目概况

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟募集资金投资额 (万元)	项目投资期
1	托伦斯精密零部件制造及研发基地项目	/	/	5年
1.1	精密零部件智能制造建设项目	87,954.48	87,954.48	-

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟募集资金投资额 (万元)	项目投资期
1.2	研发中心建设项目	7,661.57	7,661.57	-
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	-
	<b>总计</b>	<b>115,616.05</b>	<b>115,616.05</b>	-

资料来源：公司招股书，华金证券研究所

## （五）同行业上市公司指标对比

2025 年度，公司实现营业收入 7.20 亿元，同比增长 18.00%；实现归属于母公司净利润 0.98 亿元，同比减少 6.96%。根据管理层初步预测，公司预计 2026H1 实现营业收入 3.83 亿元至 3.98 亿元，较 2025 年同期增长 2.53%至 6.53%；预计实现扣非归母净利润 0.38 亿元至 0.42 亿元，较 2025 年同期减少 29.46%至 36.16%。

公司聚焦半导体设备、高功率激光器精密金属零部件领域；根据主营业务的相似性，选取富创精密、先锋精科、珂玛科技、臻宝科技为托伦斯的同行可比公司。从上述可比公司来看，2025 年可比上市公司的平均收入规模为 16.81 亿元，平均 PE-TTM(剔除异常值/算术平均)为 167.22X，平均销售毛利率为 38.16%；相较而言，公司营收规模与销售毛利率未及可比公司平均。

表 2：同行业上市公司指标对比

代码	简称	总市值 (亿元)	PE-TTM	2025 年营业收入 (亿元)	2025 年 营收增速	2025 年归 母净利润 (亿元)	2025 年归 母净利润 增速	2025 年 销售毛利 率	2025 年 ROE(摊 薄)
688409.SH	富创精密	627.67	877.98	35.43	16.58%	-0.09	-104.25%	22.23%	-0.19%
688605.SH	先锋精科	175.77	102.38	12.38	8.98%	1.89	-11.71%	29.02%	12.09%
301611.SZ	珂玛科技	575.21	232.05	10.73	25.19%	2.89	-7.04%	51.55%	17.54%
688797.SH	臻宝科技	/	/	8.68	36.73%	2.26	48.78%	49.85%	20.72%
	平均值	459.55	167.22	16.81	21.87%	1.74	-18.55%	38.16%	12.54%
<b>301583.SZ</b>	<b>托伦斯</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>7.20</b>	<b>18.00%</b>	<b>0.98</b>	<b>-6.96%</b>	<b>27.14%</b>	<b>11.78%</b>

资料来源：iFind（数据截至日期：2026 年 6 月 23 日），华金证券研究所

备注：PE-TTM 计算剔除 2025 年未盈利的富创精密以及未上市的臻宝科技。

## （六）风险提示

客户集中度较高的风险、新产品及新工艺开发风险、无法跟随工艺制程演进及半导体设备更新迭代的风险、经营业绩持续性风险、行业周期性风险、贸易摩擦风险、技术人才流失与核心技术泄密的风险、知识产权的风险、存货跌价风险、毛利率波动风险、规模增长带来的管理风险等。

## 投资评级说明

公司投资评级：

买入—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%；

增持—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%至 15%之间；

中性—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%至 5%之间；

减持—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数跌幅在 5%至 15%之间；

卖出—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数跌幅大于 15%。

行业投资评级：

领先大市—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数领先 10%以上；

同步大市—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨跌幅介于-10%至 10%；

落后大市—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数落后 10%以上。

基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普 500 指数为基准。

## 分析师声明

李蕙、戴箬箬声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

## 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

## 免责声明：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

## 风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

办公地址：

上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层

北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 05 单元

电话：021-20655588

网址：[www.huajinsec.com](http://www.huajinsec.com)